

公益社団法人精密工学会 プラナリゼーションCMP とその応用技術専門委員会 第 189 回研究会開催のご案内

このたび、プラナリゼーションCMP 専門委員会では、下記の通り、第 189 回オンライン研究会を開催いたします。会員各位の多数の皆様のご参加をお待ちしています。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。是非ご参加下さい。



日時：2021 年 4 月 26 日（月）13:00～16:10

開催場所：オンライン（Web） [※参加用 URL は当日、午前中にご案内致します](#)

[※Web 注意事項を説明します。初参加の方は当日 12:55 にアクセス下さい。](#)

プログラム：

13:00～ 13:05 開会挨拶（檜山委員長）

13:05～ 16:00 話題提供

「テーマ： 接合技術最前線：3D 積層における界面制御の重要性、デバイス応用、CMP クリーン化」

13:05-13:15 趣旨説明・Web 会議の留意事項（森永幹事・和田幹事）

1) 13:15～14:05 基調講演 1 「室温接合技術と接合面の平滑性・清浄度の重要性（原子拡散接合法を例に）」

東北大学 学際科学フロンティア研究所（電気通信研究所兼務）教授 島津武仁 氏

＜概要＞原子拡散接合法は、室温接合技術の一つであり、半導体や酸化物等のウエハだけでなく、金属やセラミックスの基体、ポリマー等を室温で接合することができます。このような室温接合技術では、接合面の表面粗さや清浄度が接合性能に大きな影響を与えます。本講演では、原子拡散接合法の特長と応用例をご紹介します。表面粗さや清浄度の重要性について述べると共に、最新の原子拡散接合法の研究についてもご紹介する予定です

2) 14:05～14:50 基調講演 2 「積層型 CMOS イメージセンサを進化させるプロセス技術」

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 第 2 研究部門 部門長 岩元勇人 氏

＜概要＞近年、CMOS イメージセンサの高性能化が急速に進められていますが、ソニーでは、2008 年に裏面照射型、2012 年から積層型の量産を開始し、現在ではセンサ画素に様々なロジック回路を積層することで高画質化と多機能化を実現しています。この実現には、Cu-Cu 接続と呼ばれる新しい平坦化&接合プロセス技術が導入されています。今回の講演では、CMOS イメージセンサのこれまでの進化とそれを実現したプロセス技術について解説するとともに異種基板接続などの新しい技術についても紹介します。

.....

14:50～15:00 休憩

.....

3) 15:00～15:30 「CMP 技術と接合技術の応用事例」

株式会社 D-process 高 文典 氏

＜概要＞(株)D-process においては、あらゆる電子デバイス用材料に対して、高効率・高品質仕上げを可能とする CMP 加工プロセスについての研究開発を進めている。昨今、注目されているのは接合前最終仕上げの位置づけとなる CMP 技術・超精密洗浄技術を含めた“超精密ウエハ接合プロセス”である。本講演では、それら超精密洗浄・CMP 接合を含めた“超精密ウエハ接合プロセス”を適用した最先端の三次元構造デバイス・MEMS デバイスなどへの応用例を紹介する。

4) 15:30～16:00 特別講演「新型コロナ禍の情報発信に見るデータ解析とその見せ方の重要性」

株式会社 ISTL 代表取締役社長 磯部 晶 氏

<概要>新型コロナは正しく恐れることが重要である。本講ではデータサイエンスの観点から、感染拡大モデル、実効再生産数や陽性率等の意味、データの取り扱いやグラフ化の際に考慮したい事項などを解説したい。ここから得られる教訓はCMPに関わる科学者・技術者として共通するものがあると考え。

16:00～16:10 連絡事項・閉会挨拶

参加費：

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円） ※今回は3名以上の参加も可
2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録） ※今回は3名以上の参加も可
3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）

※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。

※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

※ 今回のオンライン研究会には Zoom を使用させていただきます（当委員会が有する正規ライセンスの有償版）。もし、今回参加のご要望がありながら、ご利用に支障がある企業会員がいらっしゃいましたら、事前に事務局までご連絡ください。

2021 年 4 月 26 日（月）開催 第 189 回オンライン研究会 参加申込書

会員 / 一般（いずれかにチェックしてください）

氏名			
勤務先・所属			
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		

※ホームページからオンライン申し込みできます。

<http://www.planarization-cmp.org/registration>

問合せ先：「プラナリゼーション CMP 専門委員会」事務局（三上）
TEL：03-5117-2225, FAX：03-5117-2223, E-mail：mikami@global-net.co.jp